

概述

ZM8258 系列蓝牙模组是广州致远电子股份有限公司开发的一款最高支持 BLE5.2 的主从一体蓝牙模组，支持 7 路数据传输通道（3 主 4 从），同时支持数据透传和 OTA 升级等功能，具有低成本、低功耗、小尺寸等优点。

该产品使用简单方便，采用半孔工艺将 I/O 引出，帮助客户绕过繁琐的射频硬件设计、开发与生产过程，能迅速桥接电子产品和智能移动设备，满足快速开发需求，加快产品上市。广泛应用于各种电子设备，如仪器仪表、健康医疗、智能家居、可穿戴设备、汽车电子和数码产品等。

- ◆ 频率范围：2.402GHz~2.480GHz
- ◆ 无线协议：BLE5.2
- ◆ 工作模式：主从一体
- ◆ 工作电压：3.0~3.6 V
- ◆ 发射功率：-20~+10.5dBm
- ◆ 接收灵敏度：
 - -96dBm@1Mbps
 - -93 dBm @2Mbps
- ◆ 射频输出：PCB 天线/IPEX 射频连接器
- ◆ 通信接口：UART
- ◆ 温度范围：-40~+85℃

产品特性

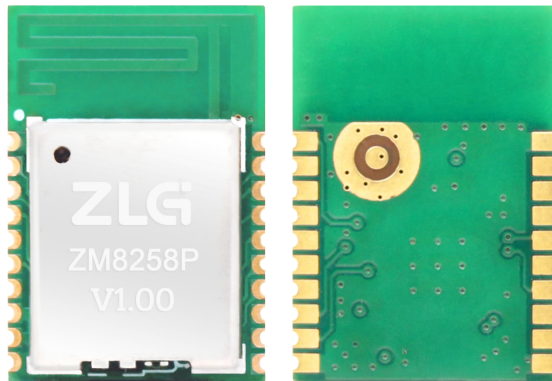
产品应用

- ◆ 工业数据采集
- ◆ 物联网智能终端
- ◆ 智能家居
- ◆ 智能遥控器

订购信息

型号	射频输出	封装尺寸
ZM8258P	PCB 天线	12.0*17.0*2.3mm
ZM8258E	IPEX	12.0*17.0*2.3mm

产品图片



修订历史

文档版本	日期	原因
V1.00	2023/07/20	首次发布
V1.01	2023/12/04	<ol style="list-style-type: none">更新 ZM8258P 产品实物图图片；模组尺寸修改：<ol style="list-style-type: none">ZM8258P 屏蔽盖尺寸公差 0.05 修改为 0.20；模组底部地焊盘到下边距 0.95 修改为 0.96。连接状态指示补充，新增可配置连接指示状态说明；唤醒引脚 wake 修改，由下降沿唤醒修改为低电平唤醒；更新功耗测试数据；修改电气性能参数，静电等级修改为±8kV；优化天线指导说明，增加模组 PCB 天线区域用户底板进行镂空处理说明；更新卷带包装图；优化文字描述，修改文档格式。
V1.02	2024/10/24	<ol style="list-style-type: none">新增 ZM8258E 型号信息；修改模组最大功率，由 8dBm 修改为 10.5dBm；新增 IPEX 射频连接器尺寸参数；更新封装尺寸---侧视图尺寸；将支持 8 路数据传输通道（4 主 4 从）改为支持 7 路数据传输通道（3 主 4 从）。

目 录

1. 产品简介	1
1.1 概述	1
1.2 产品特性	1
1.3 典型应用	2
1.4 产品选型表	2
2. 封装尺寸	3
2.1 ZM8258 系列蓝牙模组尺寸	3
2.2 IPEX 射频连接器尺寸	3
3. 引脚定义	4
4. 性能参数	6
4.1 电气性能	6
4.2 射频性能	8
5. 硬件参考设计	9
5.1 最小系统	9
5.2 推荐系统	9
5.3 电源设计	10
5.4 PCB 布板注意事项	10
5.5 PCB 天线布局指导	11
6. 生产指导	12
6.1 推荐生产回流温度曲线	12
6.2 推荐生产回流温度时间对照表	12
7. 包装信息	13
8. 免责声明	15

1. 产品简介

1.1 概述

ZM8258 系列蓝牙模组是广州致远电子股份有限公司开发的一款最高支持 BLE5.2 的主从一体蓝牙模组，支持 7 路数据传输通道（3 主 4 从），同时支持数据透传和 OTA 升级等功能，具有低成本、低功耗、小尺寸等优点。

该产品使用简单方便，采用半孔工艺将 I/O 引出，帮助客户绕过繁琐的射频硬件设计、开发与生产过程，能迅速桥接电子产品和智能移动设备，满足快速开发需求，加快产品上市。广泛应用于各种电子设备，如仪器仪表、健康医疗、智能家居、可穿戴设备、汽车电子和数码产品等。

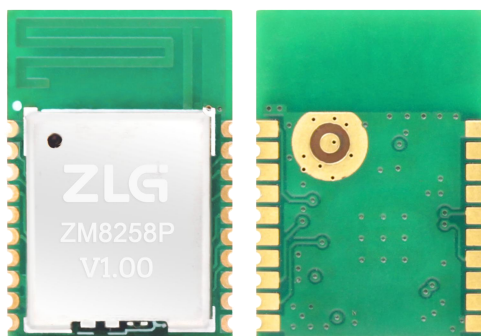


图 1.1 ZM8258P 产品实物图

1.2 产品特性

1. 蓝牙协议：BLE 5.2
2. 兼容 BLE 4.0/4.1/4.2/5.0/5.1
3. 支持主从一体工作模式
4. 支持最多 7 路数据传输通道，支持 3 主 4 从
5. 支持 OTA 升级
6. 2.402GHz~2.480GHz 免证 ISM 频段
7. AES 安全协议处理器
8. 支持透传、自定义广播包/iBeacon 模式
9. 宽工作电压 3.0~3.6V，典型值 3.3V
10. 接收灵敏度：-96dBm@1Mbps
-93dBm@2Mbps
11. 发射功率：-20dBm ~ +10.5dBm 可调
12. 尺寸：12.0*17.0*2.30mm
13. 丰富的 AT 指令：
 - 1) 支持主从共存
 - 2) 支持低功耗 1，低功耗 2 两种工作模式
 - 3) 使用通用串口设计，全双工通讯，支持波特率最低 4800bps，最高 1Mbps

- 4) 支持 AT 指令软件复位模块、恢复出厂设置、获取设备地址
- 5) 支持 AT 指令调整发射功率，更改信号强度
- 6) 支持 AT 指令动态修改广播间隔，连接间隔
- 7) 支持 AT 指令或者外部引脚恢复出厂设置
- 8) 支持 AT 指令或者外部引脚获知连接/广播状态
- 9) 支持 AT 指令进入两种低功耗模式，通过外部引脚、BLE 主机唤醒
- 10) 支持 AT 指令启动/取消连接信息打印

1.3 典型应用

- ◆ 物联网，工业控制
- ◆ 运动，医疗和健康设备
- ◆ 家庭/楼宇自动化，智能家居
- ◆ 数码产品，键盘鼠标等

1.4 产品选型表

表 1.1 产品选型表

产品型号	无线协议	工作模式	通信接口	射频输出	工作温度
ZM8258P	BLE5.2	主从一体	UART	PCB 天线	-40~+85℃
ZM8258E	BLE5.2	主从一体	UART	IPEX 射频连接器	-40~+85℃

2. 封装尺寸

2.1 ZM8258 系列蓝牙模组尺寸

ZM8258 系列蓝牙模组尺寸为（单位：毫米）：17.0×12.0×2.3。

具体尺寸图如图 2.1 所示：

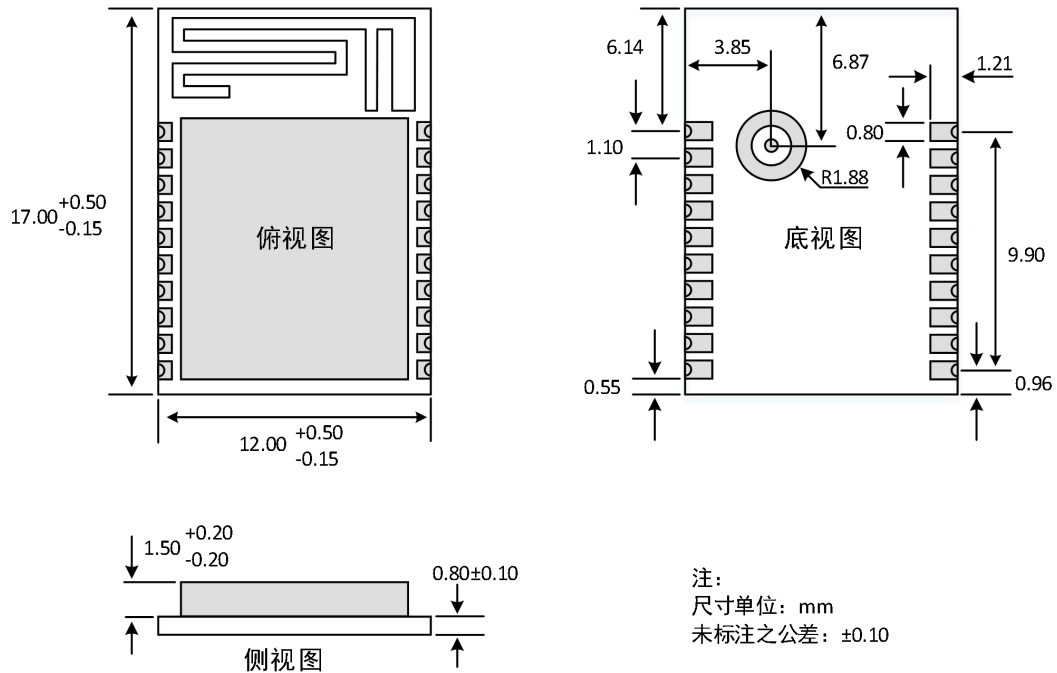


图 2.1 ZM8258 系列模组尺寸图

2.2 IPEX 射频连接器尺寸

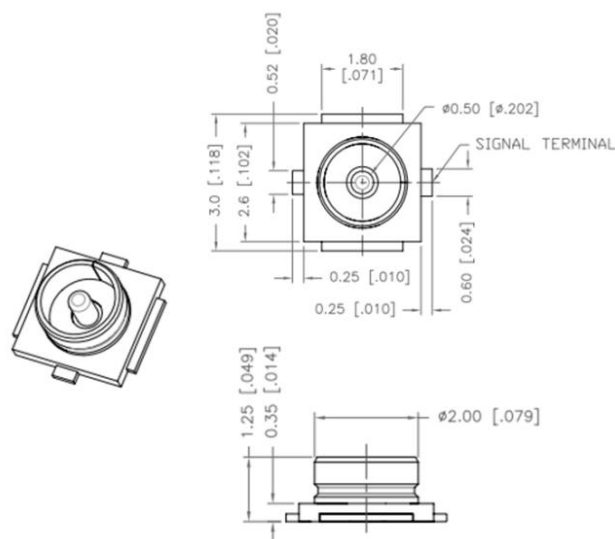


图 2.2 IPEX 射频连接器尺寸图

3. 引脚定义

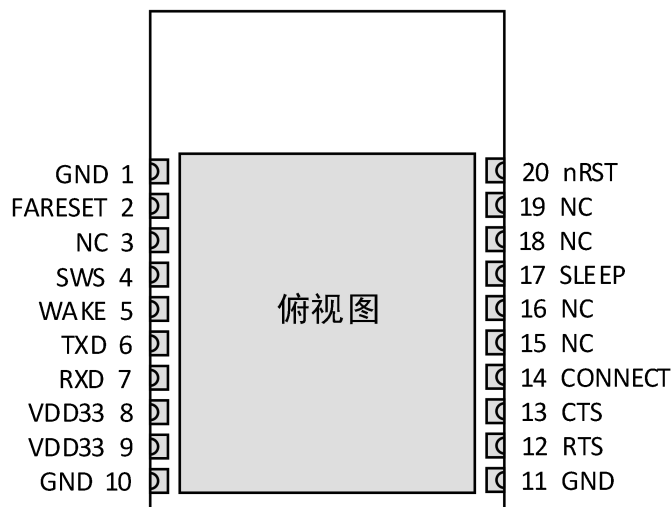


图 3.1 引脚定义

表 3.1 引脚定义说明

序号	引脚名称	类型	使用说明
1	GND	S	电源地引脚
2	FARESET	I	恢复出厂设置引脚，在全速运行模式下拉低 5s 恢复出厂设置，模块会立刻复位
3	NC	-	保留，用户悬空即可
4	SWS	-	预留调试接口，用户悬空即可
5	WAKE	I	低功耗唤醒引脚，低电平唤醒
6	TXD	I	模块串口的 TX 引脚
7	RXD	O	模块串口的 RX 引脚
8	VDD33	S	电源引脚，一定要与引脚 9 连接在一起
9	VDD33	S	电源引脚，一定要与引脚 8 连接在一起
10	GND	S	电源地引脚
11	GND	S	电源地引脚
12	RTS	O	模块串口的 RTS 引脚，用作流控，不使用串口流控可以悬空该引脚 低电平：表示模块能够接收 MCU 发的串口数据，MCU 可继续发送 高电平：表示模块不能接收 MCU 发的串口数据，MCU 应停止发送数据（考虑 MCU 响应流控信号会有延迟，所以输出高电平之后，模块仍然能够接收 300 字节的数据）
13	CTS	I	模块串口的 CTS 引脚，用作流控，不使用串口流控可以悬空该引脚 当用户 MCU 不能接收数据时：应该将该引脚拉高 当用户 MCU 能够接收数据时：应该将该引脚拉低
序号	引脚名称	类型	使用说明

14	CONNECT	0	<p>连接状态指示引脚，可通过 AT 指令进行配置，在未连接状态时，该引脚默认输出 0.5Hz 的方波，连接状态下输出低电平。具体使用配置可查阅《ZM8258 系列蓝牙模组用户手册》</p> <p>0: 未连接: 0.5Hz 方波; 连接: 低电平 (默认)</p> <p>1: 未连接: 高电平; 连接: 低电平</p> <p>2: 未连接: 0.5Hz 方波; 连接: 高电平</p> <p>3: 未连接: 低电平; 连接: 高电平</p> <p>4: 未连接: 高电平; 连接: 0.5Hz 方波</p> <p>5: 未连接: 低电平; 连接: 0.5Hz 方波</p>
15	NC	-	保留，用户悬空即可
16	NC	-	保留，用户悬空即可
17	SLEEP	0	低功耗指示引脚，全速运行模式下，该引脚为高电平，进入低功耗模式后为低电平
18	NC	-	保留，用户悬空即可
19	NC	-	保留，用户悬空即可
20	nRST	1	硬件复位，低电平有效

注：所有 NC 引脚悬空即可！

4. 性能参数

4.1 电气性能

表 4.1 电气参数

主要参数		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压		3.0	3.3	3.6	V
工作温度		-40	+25	+85	°C
存储温度		-40	+25	+125	°C
静电等级	耦合放电 (PCB 天线)	-8	-	+8	kV
	耦合放电 (IPEX)	-8	-	+8	kV
	接触放电 (IPEX) ①	-6	-	+6	kV
通信距离②	PCB 天线	-	250	-	m
	IPEX 连接器 ③	-	350	-	m

注：① IPEX 模组为外接 2.15dBi 增益天线时所测得的抗静电等级；

② 发射功率为 0dBm 条件下，在空旷地带测试所得数据，通讯距离受模块工作环境影响；

③ 外接 2.15dBi 增益天线，发射功率为 0dBm 条件下，在空旷地带测试所得数据。

表 4.2 功耗参数

工作模式	发射功率 (dBm)	广播间隔 (ms)	连接间隔 (ms)	电流	备注
正常上电	-	-	-	3.77mA	
低功耗 1 广播	0	500	-	152.46uA	
低功耗 1 连接	0	-	48.75	281.57uA	
低功耗 2	0	-	-	298.70 nA	
全速运行广播	0	500	-	3.77mA	
全速运行连接	0	-	48.75	3.80mA	
全速运行发射 (主机模式)	0	-	48.75	3.87mA	
全速运行接收 (主机模式)	0	-	48.75	3.82mA	
全速运行发射 (从机模式)	0	-	48.75	3.95mA	
全速运行接收 (从机模式)	0	-	48.75	3.87mA	
主从一体模式 (一主一从)	0		48.75	3.82mA	连接状态
主从一体模式 (一主一从)	0		48.75	3.90mA	接收数据

ZM8258 系列蓝牙模组数据手册

蓝牙主从一体模组

DataSheet

工作模式	发射功率 (dBm)	广播间隔 (ms)	连接间隔 (ms)	电流	备注
主从一体模式（一主一从）	0		48.75	3.93mA	收发数据

注：收发数据均是使用 50 字节/50ms 的速率进行数据收发；主、从机模式均为同一测试样机。

4.2 射频性能

表 4.3 射频参数

主要参数		最小值	典型值	最大值	单位
蓝牙协议		BLE5.2			-
调制方式		GFSK			-
工作频段		2402MHz~2480MHz			-
发射功率		-20	0	+10.5	dBm
接收灵敏度	@1Mbps	-	-96	-	dBm
	@2Mbps	-	-93	-	dBm
最大输入功率		-	-	-10	dBm
频偏		-25k	0	+25k	Hz

5. 硬件参考设计

5.1 最小系统

ZM8258 系列蓝牙模组提供了透明传输数据的功能，通过模组的串口实现数据的无线传输，最小系统应用只需要连接 VCC、GND、TXD、RXD 共 4 个引脚，如图 5.1 所示：

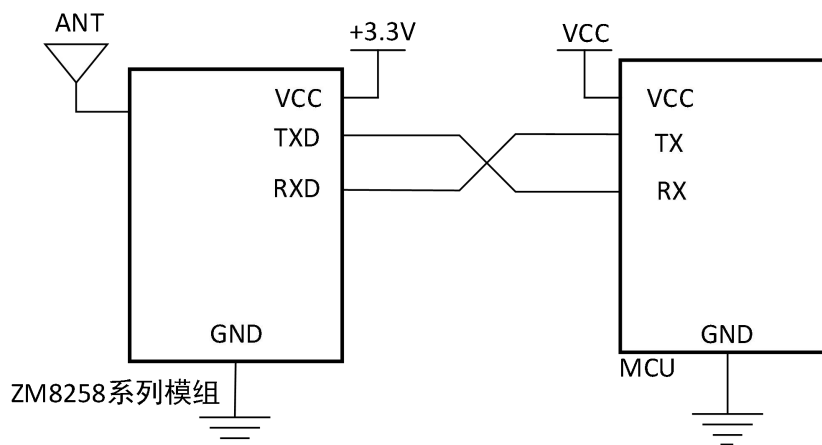


图 5.1 最小系统应用

5.2 推荐系统

ZM8258 系列蓝牙模组提供了 FARESET、nRST 和 CONNCET、SLEEP、WAKE 引脚等功能引脚，用于实现模组硬件复位、软件复位、恢复出厂设置、显示模组运行、低功耗状态指示、低功耗唤醒等功能。ZM8258 系列蓝牙模组推荐的系统应用如图 5.2 所示：

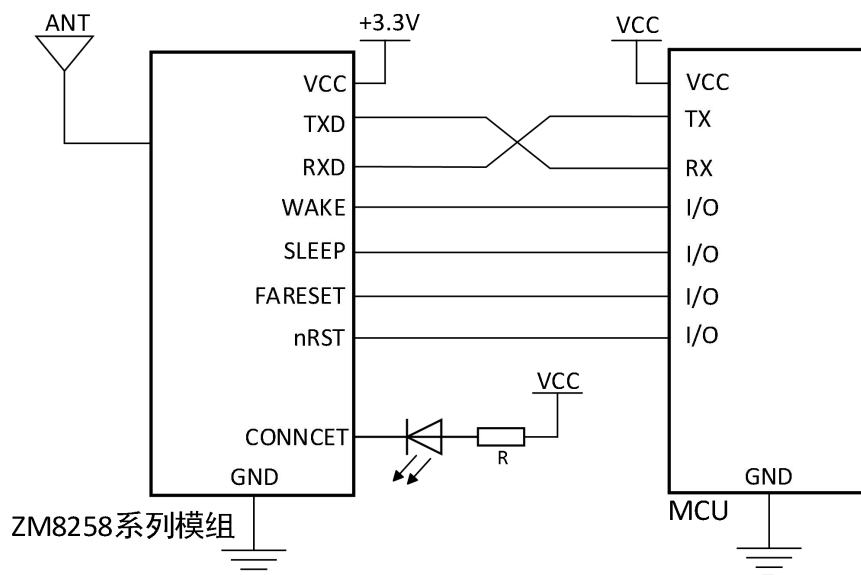


图 5.2 推荐系统应用

5.3 电源设计

电源设计的完整性影响模组性能，好的电源设计更容易发挥无线模组的性能。电源设计需要留有裕量。一般来说，在条件允许的情况下，输出电流能力需要大于峰值电流的 2 倍。如果电流裕量有限，至少也需要 1.5 倍峰值电流以上。

在 3.3V 供电系统中，过大的纹波可能通过导线或者地平面耦合到系统容易受到干扰的线路上，例如天线、馈线、时钟线等敏感信号线上，容易引起模组的射频性能变差，所以推荐使用 LDO 作为无线模组的供电电源。当使用 LDO 时，需要注意电源的散热以及输出电流。例如常用的 5V 转 3.3V，电压压降 1.7V，假设输出电流 100mA 下，则电源芯片损失的功率： $1.7V \times 100mA = 170mW$ 。

如果对不同应用不同场合中有特殊需求，可以按照 LDO 常见的参数自己选择器件，只需要保证上文的条件就可以。

常用的 3.3V 电源参考设计，如图 5.3 所示：

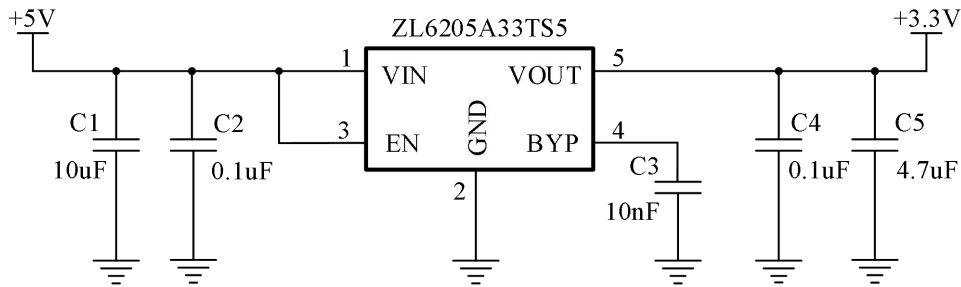


图 5.3 LDO 电源参考设计

5.4 PCB 布板注意事项

ZM8258 系列蓝牙模组背面有射频测试点，PCB 布板时需要将附近区域留空，不得走线或者铺地层。

ZM8258 系列蓝牙模组自带 PCB 天线，布板时需要在 PCB 天线下设置禁布区，禁布区的设计指导请参考下一章节的 PCB 天线布局指导。

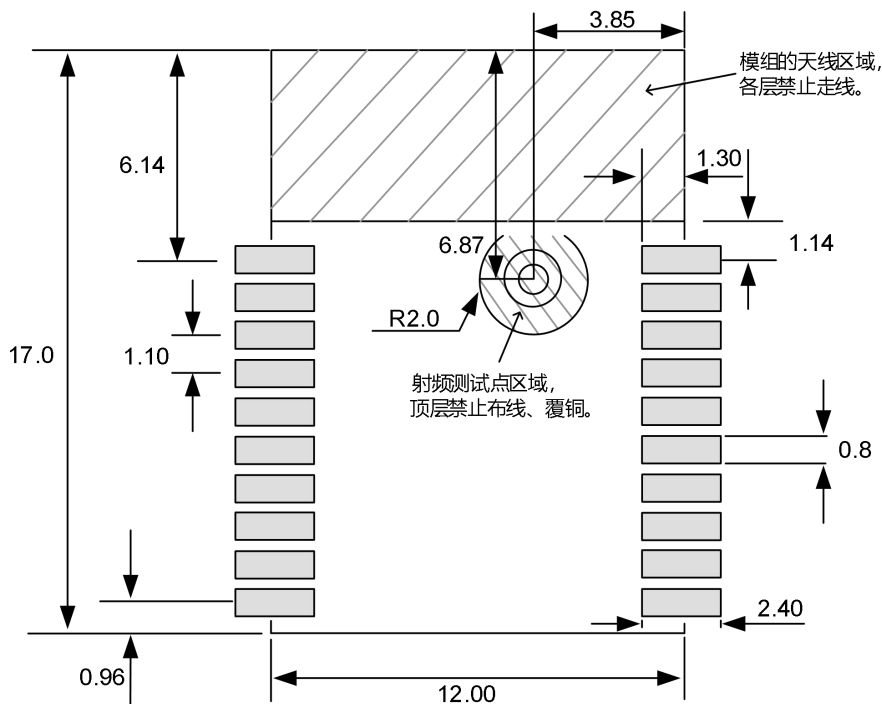


图 5.4 推荐 PCB 封装尺寸

5.5 PCB 天线布局指导

ZM8258P 蓝牙模组自带 PCB 天线，为了保证 PCB 天线的最佳性能，强烈建议客户在布局时将 PCB 天线放到底板 PCB 之外进行悬空放置，如 PCB 天线无法悬空放置，则底板在 PCB 天线区域进行镂空处理。

如果由于空间位置限制，PCB 天线无法悬空放置，可在布局时将模组放置在底板的边缘位置，并在 PCB 天线下方设置禁布区，禁布区禁止走线或敷铜，且禁布区边缘与天线应保持 20mm 以上的距离。

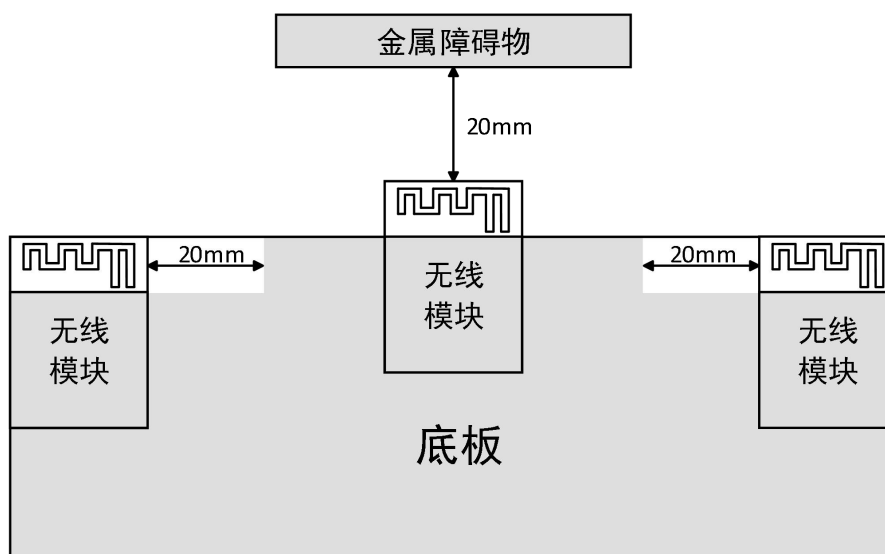


图 5.5 PCB 天线布局指导

6. 生产指导

6.1 推荐生产回流温度曲线

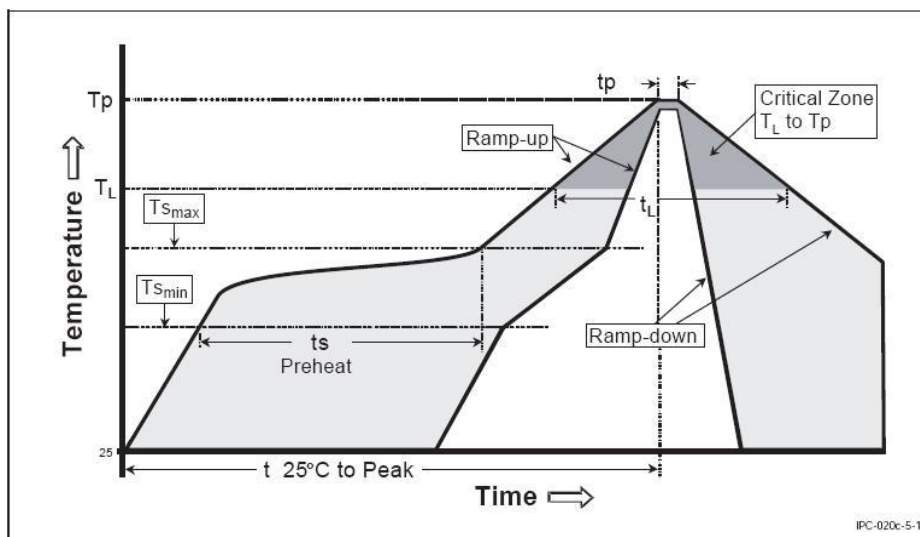


图 6.1 推荐生产回流温度曲线

6.2 推荐生产回流温度时间对照表

表 6.1 推荐生产回流温度时间对照表

Profile Feature	曲线特征	Sn-Pb Assembly	Pb-Free Assembly
Solder Paste	锡膏	Sn63/Pb37	Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Preheat Temperature min (T _{smin})	最小预热温度	100°C	150°C
Preheat Temperature max (T _{smax})	最大预热温度	150°C	200°C
Preheat Time (T _{smin} to T _{smax}) (ts)	预热时间	60-120 sec	60-120 sec
Average ramp-up rate (T _{smax} to T _p)	平均上升速率	3°C/second max	3°C/second max
Liquidous Temperature (T _L)	液相温度	183°C	217°C
Time (t _L) Maintained Above (T _L)	液相线以上的时间	60-90 sec	30-90 sec
Peak temperature (T _p)	峰值温度	220-235°C	230-245°C
Average ramp-down rate (T _p to T _{smax})	平均下降速率	6°C/second max	6°C/second max
Time 25°C to peak temperature	25°C到峰值温度的时间	6 minutes max	8 minutes max

7. 包装信息

ZM8258P 蓝牙模块采用卷带包装，每一卷包装 1800pcs，其卷带和卷盘尺寸示意图如图 7.1、图 7.2 所示，其尺寸数据如表 7.1、表 7.2，单位：mm（毫米）。

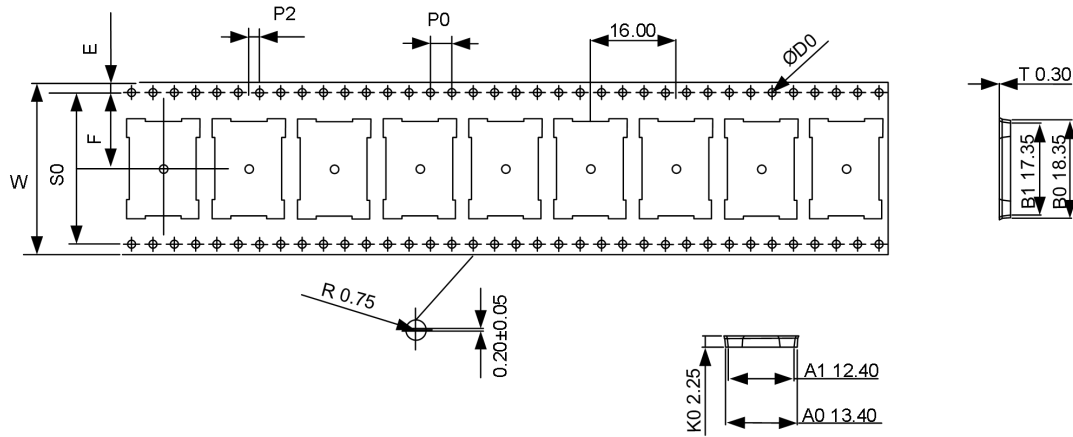


图 7.1 卷带尺寸

表 7.1 卷带尺寸数据

ITEM	W	A0	B0	K0	P	F	E	S0	D0	P0	P2	T
DIM	32.00	13.40	18.35	2.35	16.00	14.25	1.75	28.40	1.50	4.00	2.00	0.30
	±0.30	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.15	±0.10	±0.15	±0.10	±0.10	±0.10	±0.05

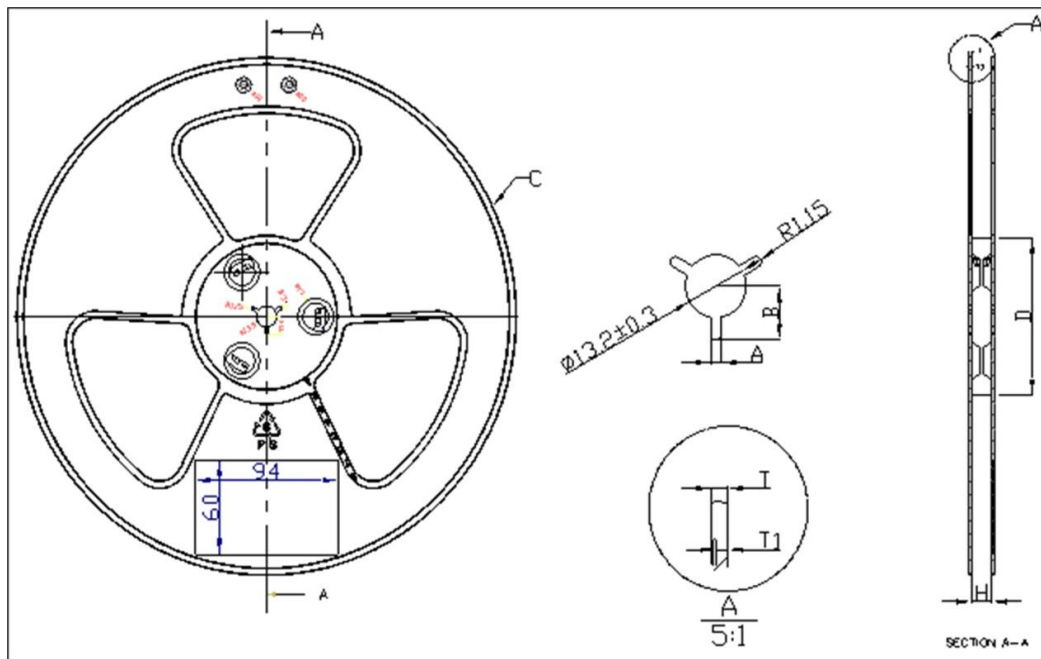


图 7.2 卷盘尺寸

表 7.2 卷盘尺寸数据

ITEM	C	T1	B	A	T	D
DIM	330±0.2	1.6±0.2	11.4±0.2	2.3±0.2	2.1±0.2	φ 100±0.2

8. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则，广州致远电子股份有限公司（下称“致远电子”）在本手册中将尽可能地向用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持！

诚信共赢，持续学习，客户为先，专业专注，只做第一

广州致远电子股份有限公司

更多详情请访问

www.zlg.cn

欢迎拨打全国服务热线

400-888-4005

